

公司代码：688125

公司简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司

2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至本报告披露日，公司总股本为80,808,080股，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以此计算拟合计派发现金红利12,121,212元（含税）。2023年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东的净利润29,166,981.42元的比例为41.56%。2023年度公司不进行资本公积转增股本，亦不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分配总额，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2023年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨明辉	陈珊
办公地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
电话	0755-86544020	0755-86544020
电子信箱	anda-ir@anda-dg.com	anda-ir@anda-dg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA 智能平台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。

历经多年发展和技术积累，公司已形成核心零部件研发、运动算法和整机结构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与包括全球电子行业头部客户及产业链 EMS 客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。

2、主要产品

公司产品主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机、等离子清洗机、固化炉、ADA 智能平台、五轴联动数控机床、超快激光设备等多种智能制造装备和点胶阀体、驱控、电机等多种核心零部件，是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备，目前已形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道工序的多元化产品布局。

(1) 流体控制设备

流体控制设备主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机和喷墨机等。流体控制设备可广泛应用于消

费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域产品的 SMT 电子装联段、FATP 后段组装的底部填充、围坝、引脚封装、堆栈封装 POP、补强、三防涂覆等工艺，以实现电子产品的贴装和部件组装。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
点胶机	AD系列 (在线)	<p>AD-16系列智能精密点胶机</p> 	<p>1.用途：用于消费电子产品、半导体产品等 SMT 段点红胶、底部填充、零件包裹、IC 补强、IC 点围坝胶、封装点胶等工艺。</p> <p>2.产品特点：XY 轴采用直线电机，运动精度更高；集成 CCD 视觉系统，可分配胶量、抓拍轨迹、扫描条码；可选配双阀同步点胶（任意选配喷射式点胶阀、螺杆阀、切割阀等）</p>
	iJet 系列 (在线)	<p>iJet-7M/7H/7L 系列高速点胶机</p> 	<p>1.用途：适用于 3C、汽车电子、MiniLED 等行业电气元器件底部填充、引脚包边、表面贴装点胶等工艺。</p> <p>2.产品特点：压电式喷射阀点胶；可适用小、中、大尺寸 PCB 板/MiniLED 板点胶；可根据工艺需求选配单轨单阀&双轨双阀或单轨双阀结构，阀间距自动调节 30-60mm；可实现四方位倾斜；可选配增压泵、激光测高系统等。</p>
		<p>iJet-9/9L/9P 系列智能精密点胶机</p> 	<p>1.用途：适用于 LED、新能源等大尺寸产品专用点胶机，包括引脚包封、表面贴装、补强、FPC 元器件（连接器、镍片、NTC 等）点胶。</p> <p>2.产品特点：单阀 X 轴点胶行程可达 860mm；可进行双板同时点胶；整机模块化设计，灵活可升级；可实现四方位倾斜；搭配 CCD 视觉系统，实时监测点胶精度和一致性。</p>
		<p>iJet-S10/S11 系列智能精密点胶机</p> 	<p>1.用途：适用于 3C、半导体封装等精密行业点胶应用工艺（包括芯片底部填充、点助焊剂、锡膏、IGBT 封装、补强等）。</p> <p>2.产品特点：压电式喷射阀点胶；可选拓展工艺模块丰富、满足客户不同点胶工艺需求；可根据工艺需求选配单轨&双轨&双阀结构，实现动态双头点胶；可实现四方位倾斜、AOI 检测；可选配加热模块开改善流动性等。</p>

	离线式点胶系列	<p>TSV-200D/300系列 桌面点胶机</p> 	<p>1.用途：热熔胶粘接、底部填充、引脚包封、堆栈封装POP、围坝与填充、点红胶、FPC元器件补强等。</p> <p>2.产品特点：设备为离线式点胶设备、桌面点胶设备，占地空间较小，采用线性模组+伺服电机驱动。</p>
	ADG系列 (在线)	<p>ADG-5DI五轴高速点胶机</p> 	<p>1.用途：热熔胶粘接、底部填充、引脚包封、堆栈封装POP、围坝与填充、点红胶、FPC元器件补强等。</p> <p>2.产品特点：（1）采用直线电机+运动控制卡；（2）使用五轴联动控制技术，可实现产品空间任意点胶轨迹需求；（3）可直接导入任何品牌的贴片机文件，也可在线视觉编程；（4）可选配激光高度检测系统，工件变形后可自动校准Z轴高度；（5）可选配精密测重系统，智能控制及检测点胶量，确保点胶的一致性。</p>
涂覆机	iCoat系列	<p>iCoat-3精密涂覆机</p> 	<p>1.用途：适用于多行业涂覆应用，可进行多拼版的涂覆，进行制程工艺多样的大面积选择性涂覆工艺。</p> <p>2.产品特点：可根据工艺需求选择多种行程规格的设备；可配备多种阀体，进行多阀排列，适应多样拼板生产需求。</p>
		<p>iCoat-5精密涂覆机</p> 	<p>1.用途：适用于对电子元器件和引脚等零件种类复杂、零件高度多变的喷涂工艺，提升对电子元器件保护强度。</p> <p>2.产品特点：可进行多方位多角度喷涂，解决高精度零件死角喷涂问题；伺服电机搭配进口模组组成传动装置,稳定性好。</p>
		<p>iCoat-6精密涂覆机</p> 	<p>1.用途：薄膜阀专用设备，用于喷涂边界清晰无锯齿无飞溅的高精度喷涂工艺。</p> <p>2.产品特点：专用的无气压供料系统搭配流体的自动加热过滤循环系统，保证流体粘度，减少气泡产生。</p>
灌胶机		<p>真空灌胶/常压灌胶机</p> 	<p>1.用途：适用于消费电子、新能源、汽车电子等行业功能模块SMT段/装配段的注胶、灌胶工艺，用于电机、变压器、控制板等密封及固定。</p> <p>2.产品特点：适用于高填料的胶水，可实现毫克级别精度灌胶，适合单组分、双组份以及多组分灌胶工艺。</p>

(2) 等离子设备

等离子设备主要有真空等离子清洗机和常压等离子清洗机，用于清洗 FPC、PCB、半导体引线支架、玻璃和各种手机零部件等表面有机物，以提高产品表面附着力，从而提升产品可靠度。



产品系列	典型产品图示	产品性能
VP系列	VP-10L在线式真空等离子清洗机 	1.用途：清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物、去静电，提高表面附着力。 2.产品特点：真空腔体采用铝合金制成，抽真空时间≤15秒，破真空时间≤5秒；输送机构采用电动调幅，宽窄可任意调节；可实现超低温清洗，温度最低至40度；异向等离子体可以进入超细狭缝来实现全方位清洗。
	VP-60/80系列全自动离线式等离子清洗机 	1.用途：清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物、去静电，提高表面附着力。 2.产品特点：真空腔体采用不锈钢制成，抽真空时间≤55-70秒，破真空时间≤15-20秒；可实现超低温清洗，温度最低至40度；异向等离子体可以进入超细狭缝来实现全方位清洗。
AP系列	AP-7/460等离子清洗机 	1.用途：对产品表面要求不高的FPC、PCB、手机零部件等表面有机物进行清洗，提高表面附着力。 2.产品特点：清洗速度快、适用广，采用步进马达+同步带传动；相较真空等离子清洗机而言，供气类型更加多样，可选压缩空气或氮气；使用成本低。
5DG-APR	5DG-APR 全自动等离子清洗机 	1.用途：适用于印刷包装、手机、电脑、塑胶、汽车、金属等行业产品的去除灰尘和油污，精细清洗和去静电，提高表面附着力。 2.产品特点：可大幅提高表面的润湿性能，形成活性的表面；采用伺服马达+滚珠丝杆传动；可选压缩空气或氮气，供气类型多样。

(3) 固化及智能组装设备

固化设备包括红外固化炉、紫外固化炉和热风固化炉，主要用于产品完成点胶或涂覆、灌胶或打印等工序后的固化或烘干。智能组装设备主要用于零部件或产品贴装、插装、锁付等工序，包括上料机、下料机和传输设备等其他设备。

ADA 智能平台是在通用机架的基础上搭载主机模组形成一个通用平台，再在通用平台基础上搭载不同的工艺模块、供料模块、输送和校准模块以快速形成一台智能平台设备，实现给什么工具和物料就能完成相应的工序工作，如点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁付、视觉检测等。ADA 智能平台的“智能”体现在设备具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的特点，能有效解决制造业设备不通用、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的行业四大痛点问题。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
固化设备	红外固化	 <p>iCure-2/3/4系列红外固化炉</p>	<p>1.用途：用于热固胶水涂覆后的固化。</p> <p>2.产品特点：双层炉腔设计，隔热效果更佳；可拆卸式温区，维护更便捷；温度精度可控制在±5℃；多段式独立控温，PID调节，节能高效。</p>
	紫外固化	<p>UV-1/2/3系列固化炉</p> 	<p>1.用途：UV胶水涂覆、点胶后的固化。</p> <p>2.产品特点：自制光源及先进变频电源技术，有效保证紫外能力稳定输出，大幅降低能耗；多样性光源组合，汞灯、无极灯管/LED、UV灯等可满足多种固化方式。</p>
	热风固化	<p>VOC系列垂直热风固化</p> 	<p>1.用途：手机背板及盖板（CG与BG）喷墨后的预固化。</p> <p>2.产品特点：每个模块采用电阻丝加热，高温马达及风轮运风，配有加热箱及整流板；采用立式固化设计，极大节省空间。</p>
智能组装及其他	ADA智能平台H系列		<p>1.用途：多工艺模块化的平台型通用设备。</p> <p>2.产品特点：整个主机模组独立控制，可快速拔插，实现工艺切换，并与MES系统连接；所有工艺模块都带有嵌入式微电脑+Linux系统，可实现软件自控与参数存储；所有工艺模块都有唯一的IP地址，快速对接上位机后能自动识别，自动运行相关软件及程序。</p>
	周边组装设备	<p>自动接驳台/上下料机</p>  <p>升降机/自动翻板机/检测台</p> 	<p>1.用途：用于SMT涂覆生产线、点胶生产线及定制化生产线中各设备之间的连接，完成生产线前后端的自动上料与收料，完成货物的升降、运输、分拣等工作，也可用PCB板之缓冲、监测的过渡阶段。</p> <p>2.产品特点：采用整体钣金焊接机架，减少设备晃动，减少胶体流动；过板宽度可根据实际需要在50-460mm范围内任意调节；控制方式采用PLC+触摸屏控制、按钮+控制板控制。</p>

	喷墨打印机	智能单彩色喷墨打印机 	1.用途：适用于PCB板、制鞋/化妆品行业、贴标签/传统丝印、精密点胶等领域印刷，实现在手机壳、亚克力、玻璃、木板上的精密涂装印刷。 2.产品特点：可支持单色打印以及彩色打印，并能实现在线实时可变打印；彩色RIP算法等控制软件完全自主开发，可根据客户的个性化需求特别定制供应。
	测试烧录分选机	芯片测试烧录分选机 	1.用途：应用于表面贴装半导体器件生产后的工序，能完成器件的电参数设置、分类甄选储存、激光打印标识、标识检测、外形尺寸检测。 2.产品特点：转盘式16工位设计；可选配盘装/编带/振动盘上下料模式；可配AOI、激光打标等多种功能。

(4) 配件及技术服务

公司销售的配件以阀体为主，包括点胶阀、涂覆阀、雾化阀、薄膜阀等，用于消费电子、汽车电子、LED、新能源等多领域的表面贴装胶、导电银浆、IC封装胶、底部填充胶、涂助焊剂或活化剂等工序环节。技术服务业务是公司为保障客户生产线的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体内容包括智能制造装备的操作培训、定期检查、维护保养、故障分析等，贯穿了客户智能化生产的全生命周期，有效提升客户黏性。

(5) 智能生产解决方案

公司除了销售单一整机设备外，还致力于为客户提供应用于PCBA加工、3D玻璃和终端组装等领域的智能生产解决方案。

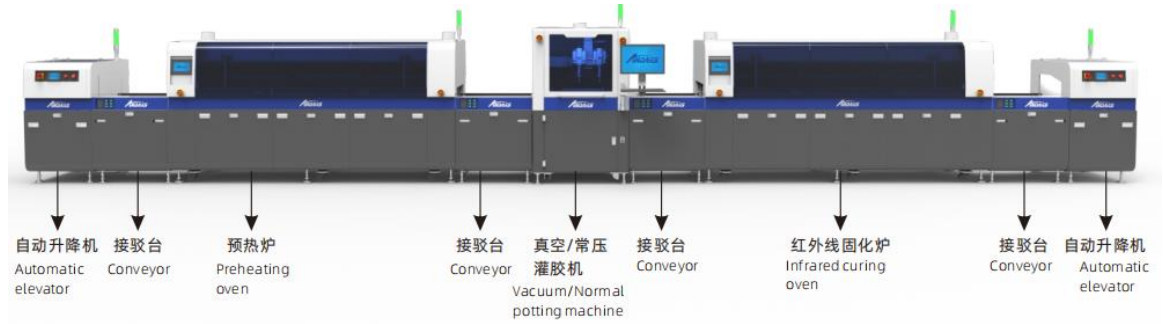
①点胶线体解决方案：该生产线以304不锈钢设计的高速点胶机系列为主体，配有自动上下料机、接驳台、UV检测台等设备，可配置单双轨&单双阀、微量天平、激光测高等，多种功能灵活搭配升级来实现不同的点胶工艺。



②PCBA板涂覆解决方案：该生产线以iCoat系列涂覆机为主体，配有自动升降机、接驳台、UV检测台、UV固化炉等装置，亦可配置双机双炉等定制化方案，最大程度保证加工工艺稳定性。



③在线真空/常压灌胶线体解决方案：该生产线包含真空/常压灌胶机、升降机、接驳台、预热炉、固化炉、全景3D相机视觉拍照、PC+PLC控制整线，为客户实现自动识别产品型号、自动灌胶、自动烘干、工装自动回流等功能。



④ADA 智能平台多模组整线方案：ADA 智能平台可以单机生产模式，亦可以多机连线的生产模式。根据产品的工艺流程、产能需求与排线平衡，公司可以为客户自定义布局模组，采用多单元和各种工艺模块的组合实现量产目的，换线只需更换模块即可，无需移动设备。ADA 智能平台不同工作站选配不同工艺模块，或与其他专用设备混搭结合使用，能实现产线的无限扩展，为快速搭建大型生产线提供一站式智能制造服务。通过搭载 LMES 系统实现离线排产、离线编程、离线生产等，使其有效解决制造业设备通用性低、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的四大行业痛点。



(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司已建立覆盖智能制造装备研发、生产和销售为一体的完整业务模式，基于产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，并通过向客户销售智能制造装备、提供配件及技术服务实现盈利。

2、采购模式

公司主要根据生产计划、研发需求以及销售订单相关的产品 BOM 清单，按需下达采购订单。此外，公司亦会根据与客户沟通的预测订单安排批量生产，并依此提前采购一部分通用物料，以满足生产排产的领料需求。公司直接采购的物料以标准化零配件为主，属于原材料采购，直接向供应商进行采购。另外，公司还会委托部分供应商进行部分五金件、机加件、电气件的简单加工，即外协加工模式，公司向其支付加工费。

3、生产模式

公司以自主生产为主，对少部分附加值较低的钣金件、机加件和电气件的简单加工以委托加工方式进行。在生产组织方面，公司主要为订单导向型，生产计划主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况执行，公司会通过与客户深入沟通，充分了解主要客户当年度的预计产能需求，并根据客户生产计划着手开始进行材料采购、制定生产计划，确保生产计划均衡分配、按时完成、准时发货；在生产工艺方面，公司产品在标准设备的基础平台上，通过加载工艺模块、变更关键核心零部件或优化运动算法等方式，即可满足客户多样化的工艺需求。当客户有特殊的工艺需求时，公司亦会根据客户需求定制化生产。

4、研发模式

公司建立了前沿技术中心+研究院+研发中心“三层”研发体系。其中，前沿技术中心负责智能制造工业互联网、人工智能的研发；研究院牵头基础研发，主要负责基础模块建设、核心零部件研发；研发中心则负责标准产品、ADA 智能平台产品的研发，并针对市场及客户对产品的工艺要

求进行产品升级研发，解决客户现场的应用问题。

5、销售模式

公司产品以直接销售为主。公司依托深厚的技术积累和快速交付等优势，实现了与全球电子信息产业头部客户及其 EMS 厂商的互赖互信，建立了长效而稳定的合作机制。公司直接与客户或其 EMS 厂商签订订单并直接发货，为其提供相关的智能制造装备及解决方案、零配件和技术服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 公司所属行业及确定依据

公司主营业务为部品研发、流体控制设备、等离子设备、固化及智能组装设备等智能制造装备的研发、生产、销售及技术服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》（国家标准第 1 号修改单），属于“C3569 其他电子专用设备制造”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），属于“2.1 智能制造装备产业-3569 其他电子专用设备制造”；根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司产品属于“2.1.4 智能加工装备”中的“智能基础制造装备”。

(2) 行业发展阶段

公司广义的行业分类属于智能装备制造业，生产的流体控制设备属于更为细分的电子专用设备制造行业。智能装备制造的技术水平是下游制造业突破工艺和产能限制的关键技术瓶颈。电子信息制造业向高精度、小型化方向发展的速度加快，对生产工艺变革的速度提出了更高要求，亦将带来对智能制造装备的更新换代需求。但目前智能制造装备普遍存在定制化程度高的特征，因此生产工艺的迭代对生产线的柔性化需求不断加大。

当前，制造业自动化面临四大行业痛点，即：自动化设备通用性低、故障排除时间长、操作门槛高、柔性化不足。以设备通用性为例，各类电子产品因生产工艺不同需使用专用电子设备，同一产品生产线因工序环节不同，亦需不同的生产设备进行生产。基于以上行业痛点，使得企业智能制造装备购置、人力资源培训、设备更新换代等成本较高，将成为制约电子信息制造业推动自动化和智能化升级的重要因素。

(3) 行业基本特点

①下游行业的高增长推动可持续发展

智能装备制造业的下游应用领域非常广泛，主要包括消费电子、新能源、汽车制造、半导体、医疗器械、家居等行业。其中，因 3C 产品的消费属性明显、产业庞大、更新换代周期较短，所以智能装备在消费电子领域得到了较快发展。目前，起步较早且竞争激烈的消费电子逐渐趋于稳定发展态势，相较之下，我国光伏、新能源汽车、储能、半导体市场正处于快速发展阶段，智能装备是这些下游企业生产经营的基础设备，下游行业的快速增长将会显著推动智能装备市场容量的扩大，应用市场前景广阔。

②关键核心零部件技术积累薄弱

核心零部件的结构设计和加工精度是影响智能装备技术水平的重要因素之一，其发展对提升制造业的竞争力和生产效率有着重要作用。由于我国高端制造业起步较晚、基础较薄弱，对制造业上游的覆盖力尚显不足，虽然目前部分企业已开始针对性地进行核心零部件的研发，但在部分高端制造领域的关键零部件、关键基础材料、加工工艺等方面的制造仍缺乏配套支持，与发达国家领先水平存在较大差距，对外依存度仍然较高。2023 年，中央经济工作会议部署 2024 年重点

经济工作任务，要求围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。基于此，国内各地围绕制造业重点产业链正不断加强自主创新拓展，促进关键核心零部件技术积累，有利于夯实国内民族企业科技创新的主体地位，推动产业链和供应链的自主可控。

③高端制造领域的设备国产化程度正逐步提升

智能制造装备行业是国际竞争的焦点行业，历经多年发展，我国自主研发和生产的各类智能制造装备已覆盖多种电子产品的多个工序环节，基本满足了电子、汽车、工程机械、物流仓储、医疗等领域对中低端自动化设备的需求。近年来，国家陆续推出了鼓励高端装备制造业的政策，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。目前在高端制造领域，国内也涌现出具有较强竞争力的智能装备制造企业，拥有较为完善的技术创新体系及强劲的创新能力，能够独立研发自动化设备高端产品，部分产品的核心技术已经达到国际先进水平。

(4) 主要技术门槛

①技术壁垒

智能制造装备行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业，综合多个学科和技术领域且更新迭代快，是下游终端制造业突破工艺和产能限制的关键瓶颈，因此需要企业在包括先进制造、光学成像、机械系统、电气控制、信息技术、人工智能等领域进行大量技术积累，需要持续的研发投入以及储备多年的行业应用经验，对下游行业技术变革具备深刻理解，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

②应用领域的行业经验壁垒

面对市场不断变化的终端产品，客户对智能制造装备的稳定性、精密性、安全性、可靠性以及供应商的售后服务和技术支持能力有较高的要求。智能制造装备企业需要根据客户行业特点、行业规范、货品类型、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行解决方案设计，以便更好地服务客户，因此下游客户更青睐于拥有较强的研发设计能力、丰富的项目实施经验、专业化的项目管理团队，并能够提供长期售后服务的设备制造商，这才是行业的客观需求和长期发展趋势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司于 2010 年推出经广东省电子学会 SMT 专业委员会认证的“国内首款全自动多功能高速点胶机”，是国内较早专业从事流体控制设备研发和生产的公司，此后不断推出各类智能制造装备，逐步加深在 SMT 电子装联、FATP 后段组装、TP 触摸屏涂覆等工序的应用。

在业务方面，公司目前奠定了以流体控制应用为核心产品基础，同步覆盖点胶、涂覆、等离子清洗、固化、智能组装、柔性生产等多道工序环节的多元化产品布局，已发展成为中国名优企业、省级认定企业技术中心、省级知识产权示范企业、省级博士工作站等等。

在技术方面，公司基于多年对基础技术的积累，围绕智能制造装备形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局，并在点胶机、涂覆机、智能 ADA 平台设备等核心产品领域具备了技术优势，是中国著名品牌（高速点胶机、智能涂覆机、等离子清洗机、ADA 智能组装设备系列）、广东省高新技术产品（点胶机、涂覆机）、符合使用采用国际标准产品标志条件（全自动高速 PCB 封装点胶机）等，在业内大客户及其产业链中具有较高的知名度和美誉度。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着全球工业水平的提升，全球电子信息制造业不断向着高精度、低功耗、高效率、高集成、

小型化和智能化等方向发展，终端产品在高精、高速、高质的追求上不断提升，一方面是对加工精度、装配工艺、效率产能、一致性和安全作业要求提升，部分工序无法继续以人工方式进行，需以电子专用设备替代；另一方面对加工所用的电子专用设备的精度、速度、稳定性、和特殊参数提出了更高要求。因此，随着电器元器件向微型化方向不断进步，电子信息制造业对加工工艺及设备的要求亦在不断提升，在为智能制造装备行业带来持续稳定的市场需求同时，亦对智能制造装备的技术提出了更高要求。

(1) 新技术

在 5G 通讯、芯片制程、材料工艺改良和人工智能 AI 等技术进步的推动下，终端电子产品更新迭代速度将不断加快，从而使得电子信息制造业需不断改变生产工艺，对电子专用设备的柔性化需求将大大提升。例如：自去年 ChatGPT 爆火，生成式 AI 的浪潮直接席卷了各个行业，而消费电子各大厂商都在积极探索与 AI 大模型融合发展的新契机。由 GfK 与中国电子商会在 2023 年 10 月联合发布的《2023-2024 中国科技类消费电子产业发展白皮书》中提到，消费电子作为 AI+应用的承载终端，将加速下游产业的更新换代及复苏节奏，理应开启新一轮周期，必将带来对智能制造装备的更新换代需求。

(2) 新产业

①AI 手机及 AI+XR

当手机植入 AI 大模型之后，经过数据训练，各 APP 之间壁垒可以被打破，手机可以成为真正的个人智能助理。随着承载 5G、AI 技术之上的智能应用越来越多，更强大的智能手机会成为消费者的主流和标配，还能推动产业链增值服务（比如音频配件、电源配件、可穿戴设备、智能家居云服务等）的快速增长。

随着我国居民消费升级，消费者对于智能穿戴、AR/MR/VR 设备等新兴智能终端产品需求强劲。其中 AR/MR/VR 行业正处于高速发展阶段，有了生成 AI 的加持，用户的数字体验将扩展到以前可能的范围之外，助力各类云服务、云生产、云体验的应用场景丰富。随着国内外科技龙头企业逐步入场，相应的 AI+XR 软硬件也将迎来关键升级，未来市场空间十分广阔，非常期待市场放量后的智能装备需求。

②新能源汽车及新兴氢能

随着能源技术和生产力不断进步，国家坚定推进“双碳”战略，正推动着一场波澜壮阔的能源革命。2024 年 3 月 5 日，十四届全国人大二次会议作的《政府工作报告》中，针对“积极培育新兴产业和未来产业”部分提到：“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。

新能源汽车成为连接能源、电子、智造、物联网等众多行业跨界融合的交汇产品，创新前景和蕴含的商业价值十分广阔；而氢能作为前沿新兴产业被《政府工作报告》重点提及，亦意味着新型储能行业有望迎来更好地发展。公司先前就已对上述前沿产业进行了储备，并参与到项目研发、打样、小批量验证及交付等过程中，未来将进一步加强市场的拓展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	215,464.787388	205,780.853066	4.71	85,309.32
归属于上市公司股	190,192.421523	190,131.989317	0.03	69,272.53

东的净资产				
营业收入	47,240.843404	65,131.552589	-27.47	62,811.32
归属于上市公司股东的净利润	2,916.698142	15,711.393279	-81.44	15,277.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,320.57	15,164.46	-91.29	14,318.85
经营活动产生的现金流量净额	6,144.854497	14,046.805956	-56.25	12,907.57
加权平均净资产收益率(%)	1.53	10.59	减少9.06个百分点	24.99
基本每股收益(元/股)	0.36	2.12	-83.02	2.52
稀释每股收益(元/股)	0.36	2.12	-83.02	2.52
研发投入占营业收入的比例(%)			增加9.81个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	140,422,487.37	81,494,096.32	102,080,000.69	148,411,849.66
归属于上市公司股东的净利润	29,190,245.52	1,680,603.12	467,659.05	-2,171,526.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,046,421.01	2,060,469.81	-1,494,175.47	-12,407,065.20
经营活动产生的现金流量净额	32,678,123.60	36,678,991.39	15,198,606.26	-23,107,176.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,058
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,483
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数	0

(户)								
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0			
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
东莞市盛晟实业投资有限公司	0	42,628,800	52.75	42,628,800	42,628,800	无		境内 非国 有法 人
东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)	0	9,001,260	11.14	9,001,260	9,001,260	无		境内 非国 有法 人
刘飞	0	4,800,000	5.94	4,800,000	4,800,000	无		境内 自然 人
何玉姣	0	2,549,940	3.16	2,549,940	2,549,940	无		境内 自然 人
中金公司—杭州银行—中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-107,963	1,551,945	1.92			无		境内 非国 有法 人
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	967,891	967,891	1.20			无		其他
张继军	-103,680	916,320	1.13			无		境内 自然 人
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	858,326	858,326	1.06			无		其他

中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划	771,797	771,797	0.96				无	境内非国有法人
上海清淙投资管理有限公司－清淙睿智二号私募证券投资基金	444,685	444,685	0.55				无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			刘飞、何玉姣系夫妻关系，两人是公司实际控制人，共同控制东莞市盛晟实业投资有限公司；东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）系公司的员工持股平台，刘飞担任执行事务合伙人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用					

存托凭证持有人情况

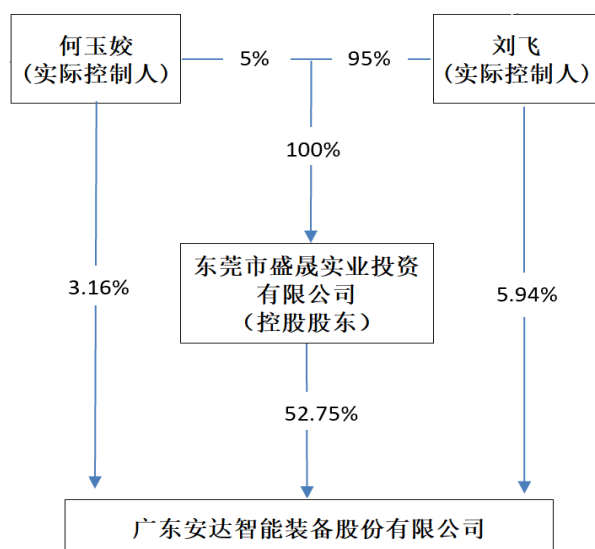
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

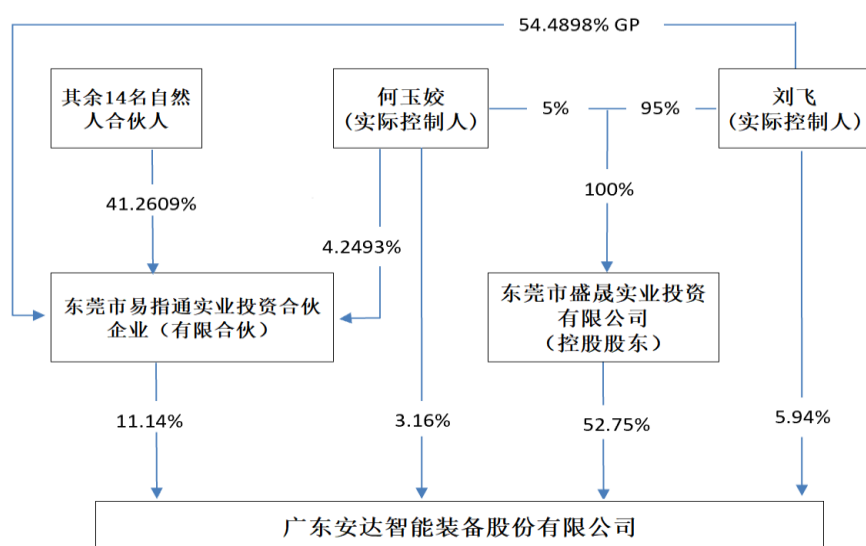
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司实现营业收入 47,240.84 万元，较上年同期下降 27.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,916.70 万元，较上年同期下降 81.44%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,320.57 万元，较上年同期下降 91.29%。

2023 年期末，公司总资产为 215,464.79 万元，较期初增长 4.71%；期末归属于母公司的股东所有者权益为 190,192.42 万元，较期初增长 0.03%。

(1) 营业收入同比下降的原因分析：

报告期内，公司营业收入的主要贡献来自于消费电子、汽车电子、半导体、新能源等几个下游应用领域，其中消费电子领域是公司目前下游应用中最大的一个板块。2023 年，行业景气度及需求低迷等不利因素仍存在，行业整体工艺创新不大，影响了主要客户产业链对智能制造设备的需求，导致公司产品出货及收入同比下滑。智能手机、个人电脑、平板电脑是消费电子行业最具代表性的电子产品，它们在过去一年里整体销量均出现了下滑。根据 Canals 机构公布的统计数据显示：在智能手机方面，2023 年全年，全球智能手机出货量为 11.4 亿部，与 2022 年相比下降了 4%，其中 2023 年上半年出货表现惨淡，Q1 季度、Q2 季度出货分别同比下滑 13%、10%，下半年起的同比跌幅才有所收窄；在个人电脑（PC）方面，2023 年全年，全球个人电脑（PC）出货量为 2.47 亿台，与 2022 年相比下降了 13%，其中仅 2023 年 Q4 季度的 PC 市场出货量同比增长 3%，

结束了连续七个季度的同比下滑；在平板电脑方面，2023 年全年，全球平板电脑的出货量为 1.353 亿台，与 2022 年相比下降了 10%。

综上所述，2023 年是消费电子行业低迷的一年，虽然 2023 年底行业景气度开始温和回暖，但尚未恢复至理想水平，同时因电子终端产品工艺创新不大，公司国际大客户及其供应链厂商的采购量受到影响，导致公司 2023 年产品出货及验收同比减少，给收入端造成了一定的影响。

（2）净利润同比下降的原因分析：

2023 年，在消费电子行业低迷导致公司收入下降的背景下，公司依然坚持加大产品品类拓展、加大研发投入、加大市场营销开拓，为公司长远发展打下了基础。与此同时，公司毛利率阶段性承压，费用率阶段性上升，从而影响了公司净利润的表现。

在毛利率方面，2023 年，公司进一步丰富了产品系列和种类，因公司产品收入结构发生一定的变化、高毛利产品收入占比下降等综合因素影响，公司整体毛利率较去年同期有所下降。

在研发投入方面，2023 年，公司研发投入 10,025.42 万元，占公司营业收入的比例为 21.22%。公司十分注重研发投入，通过对核心部件、关键软件等底层技术的研究投入，掌握智能装备的关键技术，从而打造公司技术竞争力。报告期内，公司大量引进了优秀的研发人才，主动引入了多位在光电学、流体力学、电磁、电机、激光、运动控制、AI 算法、工业互联系统等方面的专家教授、博士，组建了流体与结构、视觉、机器人、电力电子、驱动与控制、电机六大研究所，不断夯实公司基础底层技术及产品研发能力。报告期内，公司持续升级 ADA-H 智能平台，2023 年进行了 Z 轴电机自主化开发、工艺模组热插拔及软硬件的二级解耦和三级解耦，通用平台与工艺应用全面适配，使其能完成对多种工艺模组即插即用，支持更精细的工艺需求，真正实现由专用功能设备转变为通用数字化平台设备。同时，公司对传统灌胶机、等离子清洗机、喷墨打印机设备进行研发升级，推出了毫克级别精度灌胶机系列产品、智能单彩色喷墨打印机系列产品和常压尖嘴等离子体、高速旋转等离子体，并成功研发出了高端精密机床、超快飞秒激光等产品，丰富了公司产品品类。基于上述研成果丰硕，公司 2023 年度提交申请专利 49 件，截至 2023 年年底，公司累计申请了专利 484 件。

在销售费用方面，2023 年，公司销售费用 13,089.03 万元，占公司营业收入的比例为 27.71%。报告期内，公司持续巩固消费电子行业的大客户，并加大了对汽车电子、半导体、新能源等行业大客户的拓展力度，为此，公司引进了一批熟悉相关行业工艺应用的营销人才，因此报告期内公司销售费用比去年同期均有所增加。目前，除了消费电子行业国际大客户及其供应链厂商之外，公司已获得特斯拉、比亚迪、捷普、印度 TATA 等众多国内外大客户供应商资质，未来公司将围绕更多大客户做深耕。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用